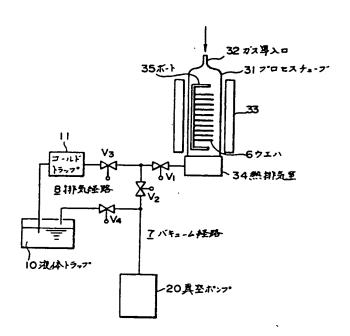
# 第 2 図



### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-218013

(43)Date of publication of application: 31.08.1989

(51)Int.CI.

H01L 21/205 H01L 21/31

(21)Application number: 63-045060

.....

(21)Application name

(71)Applicant :

TEL SAGAMI LTD

(22)Date of filing:

26.02.1988 (72)Inventor:

**FUSE NOBORU** 

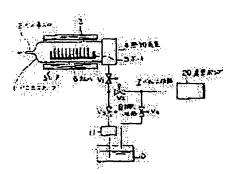
SAKAMOTO SADAO

### (54) REACTION APPARATUS

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To prolong the lifetime of an evacuation route and an evacuation—driving source by trapping a by-product produced inside a reaction chamber in a halfway part of the evacuation route in order to solve a conventional problem of corrosion or the like to be caused by a discharge of the by-product.

CONSTITUTION: A liquid trap 10 containing, e.g., water as one example of a trap means used to trap at least a corrosive product out of a product is arranged in an evacuation route 8. When a vacuum pump 20 is driven, a residual gas inside a process tube 1 is introduced into the liquid trap 10 via a heat evacuation chamber 4 and the evacuation route 8. Since HCl as a reaction by-product is water-soluble, it can be dissolved in the water after it has been passed through the trap 10; the HCl can be trapped. It is possible to sharply reduce that the HCl as a toxic gas is discharged to the subsequent route 8; the damage of the vacuum pump 20 can be reduced. By this setup, the lifetime of the route 8 and an evacuation-driving source can be prolonged.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ® 公開特許公報(A) 平1-218013

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成1年(1989)8月31日

H 01 L 21/205 21/31 7739-5F 6824-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

会発明の名称 反応装置

②特 願 昭63-45060

@出 願 昭63(1988) 2月26日

個発明者 布施

見 姉本川間浄ケゴ

神奈川県津久井郡城山町川尻字本郷3210番1 テル・サー

ムコ株式会社内

@発明者 坂本 禎男

神奈川県津久井郡城山町川尻字本郷3210番1 デ

テル・サー

ムコ株式会社内

勿出 願 人 テル相模株式会社

神奈川県津久井郡城山町川尻字本郷3210番1

砚代 理 人 弁理士 井 上 一 外1名

### 明細部

#### 1. 発明の名称

反応装置

### 2. 特許請求の範囲

反応室に連通する排気経路途中に、少なくとも 反応制生成物をトラップするトラップ手段を設け たことを特徴とする反応装置。

### 3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

木 発明は、反応装置に係わり、特に、反応に よって生成する副生成物を排気経路途中でトラッ アすることができる反応装置に関する。

#### (従来の技術)

この種の反応装置の一例として、半導体ウエ ハにシリコン原を形成するためのシリコンエピタ キシャル成長装置を挙げることができる。

上記装置では、原料ガスとしてたとえばSI H2C & 2を加熱下のプロセスチューブ内に導入 し、この原料ガスをH2と反応させて得たSIを、 前記半導体ウエハに結晶成長させるものである。

そして、この生成物は前記プロセスチューブの 排気経路に真空ポンプ等を接続し、上記反応副生 成物等を強制排気するようになっている。

### (発明が解決しようとする問題点)

上述した従来の反応装置では、HC L 等の腐蝕性ガスを単に強制排気していたので、排気経路特に真空ポンプの損傷が著しく、その野命を大幅に締めるという問題があった。

また、上述したシリコンエピタキシャル成長装置では、半導体ウエハに付着しないシリコンSiは、パウダー状で排出されるため、排気経路途中を目詰まりさせ、あるいは真空ボンブの機能を故障させるという問題もあった。

そこで、本発明の目的とするところは、上述した従来の問題点を解決し、反応副生成物を排気経路途中でトラップして、排気経路の腐蝕を防止し、 真空ポンプ等の排気刷動源の舞命を高めることが できる反応装置を提供することにある.

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明は、反応室に運道する排気経路途中に、 少なくとも反応副生成物をトラップするトラップ 手段を設けた構成としている。

そして、反応室内を減圧して反応を実行する減 圧反応装置にあっては、排気駆動源と反応室を真 空に引く駆動源とを真空ボンプとして裁用する場 合、反応室を真空に引くバキューム経路のバイバ スとして前記トラップ手段を設けるものが好まし い。また、トラップ手段としては、液体トラップ を使用するものが好ましい。

(作用)

反応室内で生成された反応副生成物は、その排気を行う際に、排気経路途中でトラップ手段によって構築されるので、以降の排気経路には、反応副生成物が除去され、もしくは大幅に低減された排気ガス等のみとなるので、たとえ反応副生成物としてHC & 等の強酸が含まれていたとしても、

これを除去して排気することができるので、排気 矢の腐蝕を低減し、また、真空ポンプギの排気駅 動源の劣化を低減できるので、その寿命を大福に 高めることができる。

そして、上記トラップ手段として液体トラップを使用した場合には、HCI等の水溶性の副生成物は水に溶かし込むことによってトラップでき、SI等のパウダー状の固体は沈緑によってトラップすることができ、この他、水との反応によってトラップすることも可能となる。

また、減圧反応装置にあっては、真空引き経路 とトラップ手段の経路とを切り替えることにより、 真空引き作用をトラップ手段によって阻害されず に効率的に実行することができる。

"(実施例)

以下、本発明をシリコン気相エピタキシャル 成長(CVD)装置に適用した一実施例について、 図面を参照して具体的に説明する。

横型のたとえば石英チューブから成るプロセス チューブ1の一端にはガス導入口2が設けられ、

その他端には無排気室4が形成され、このプロセスチューブ1内には前記無排気室4側よりボート5が搬入出可能となっていて、このボート5上に所定距離の面間をとって垂直に立て掛けられた複数枚の半導体ウエハ6が搭載されるようになっている

前記ガス郷入口2からは、反応的に導入される不活性ガスたとえばN2ガス、反応に使用されるH2ガス及び原料ガスとしてのたとえばSiCl4等が導入されるようになっている。なお、前記原料ガスとしては、この他SiH4。SiH2Cl2、SIH3Cl等を使用することもできる。また、前記プロセスチューブ1の周囲には、加熱下で気相エピタキシャル成長を実行するためのヒータ3が配置されている。

前記プロセスチューブ1の他端側に配置されている無排気室4には、前記プロセスチューブ1内を真空に引いて減圧するためのバキューム経路7と、このバキューム経路7に対してバイパスを構成する排気経路8とが接続されている。なお、こ

の種の経路を構成する配管としては耐腐蝕性のあるたとえばステンレス管等が使用されている。

そして、前記無排気室4の直接の配管途中には 第1のパルプV1が、前記パキューム経路7途中 であって前記パイパス接続端の間には第2のパル プV2がそれぞれ設けられている。

一方、前記排気経路8には、たとえば水を収容した、生成物少なくとも腐蝕性生成物を補集するトラップ平段の一例としての液体トラップ10かの排気原本にはコールドトラップ11及び第3のバルブV3が、液体トラップ10からの排気原出に関いてはある。なお、上記第1~第4のバルブV1~V1は、プロセス工程に応じてCPUの指令に基づき開閉駅動が制御されるようになっている。

また、前紀パキューム経路7及び俳気経路8の 共通の駆動源として、真空ボンプ20が配置され ている。

次に、作用について説明する。

先ず、プロセスチューブ 1 をヒータ 3 によって 加熱すると共に、このプロセスチューブ 1 内へポ ート 5 を搬入する前にあっては、前記ガス 導入口 2 より不活性ガスとしての N 2 ガスを導入し、空 気等を十分に排除しつつポート 5 の搬入を実行す る。

その後、プロセスチューブ1内の減圧を実行する。すなわち、第1、第2のバルブV1、V2をオープンとし、第3、第4のバルブV3、V4をクローズとし、バキューム経路7のみを使用可能な状態として真空ボンプ20を駆動し、プロセスチューブ1内を所定値の減圧下に設定する。なお、必要に応じて、前型N2 ガスの導入による空気の排除作業と、真空引き作用とを繰り返し実行することもできる。

上述した前処理工程の終了後であって、かつ、プロセスチューブ 1 内の温度が所定の反応温度に設定された状態で、前記プロセスチューブ 1 内にガス導入口 2 を介して水素ガスH2 と原料ガスとしてのたとえばSiCℓ 4 を導入する。

切り替えは、第2のバルブV2をクローズとし、 第3、第4のバルブV3、V4をオープンとする ことで連成できる。

この切り替え動作終了後、真空ボンプ20を駆動すると、前記プロセスチューブ1内の残留ガス等は無排気室4及び排気経路8を介して液体トラップ10に導入されることになる。

この液体トラップ10では、下記のようなトラップ作用を実行することになる。

先ず、反応副生成物であるHC!は水溶性であるので、前記液体トラップ10を過過させることによってはより、これを水に溶かし込むことによってHC!の補集が可能となる。このように、強酸であるHC!を排気経路途中で補集することによって、以降の排気経路8には有湯ガスであるHC!が排出されることが大幅に低級され、特に金属でが成されて腐蝕性ガスの耐久性に乏しいできるので、その対命を従来よりも高めることが可能となる。

また、上述した液体トラップ10を設置するこ

そうすると、加無下にあるプロセスチューブ:1 内では、下記の無反応が実行されることになる。

S i C ! 4 + H 2 - S i + H C !

そして、上記反応によって生成されたシリコン Siが、Siエピタキシャル別として、耐記ポート5上の各半導体ウエハ6上に生成され、シリコンエピタキシャル成長が実行されることになる。

ここで、上述した無反応では、Siの他にその 反応副生成物として強酸であるHCℓが生成され ている。また、反応によって生成したSiは全て Siエピタキシャル層として使用されるわけでは なく、その一部はSiのパウダー状固体としてプロセスチューブ1内に残倒することになる。また、プロセスチューブ1内には未反応の前記原料ガス 及びH2ガスが残留している。

そこで、上述したシリコンエピタキシャル成長 終了後に、プロセスチューブ 1 内を強制排気して いる。このため、本実施例では無排気室 4 に接続 されているバキューム経路 7 をバイパスして排気 経路 8 のみを使用して排気を実行している。この

とで、上記反応湖生成物以外のトラップをも可能 である。

すなわち、シリコンエピタキシャル成長に供されなかったSiは、パウダー状の個体として排出されることになるが、このパウダー状の固体が前記液体トラップ10を過過することによって、耐力が一状のSIを揺することができる。このように、パウダー状のSIを揺することによって、配管法中及び真空ボンプ10である。 の目請まりを解消することができ、配管、スタボンプのメインテナンスが簡易化される。

さらに、未反応の原料ガスであるSiC & 4 が 前記液体トラップ 1 〇を通過すると、下記の反応 によってシリカSi〇2 と塩酸HC & に分解され て液体トラップ 1 〇に抽集されることになる。

S I C & 4 + H 2 O - S I O 2 + H C &

なお、上記反応は発熱反応であるので、液体ト ラップ 1 0 を冷却するように構成することもでき

このように、本実施例によれば排気経路8途中

に液体トラップ10を配置することで、副生成物等をトラップすることができるので、従来のよう に副生成物等をそのまま排気していたものに比べ れば、排気軽陽の寿命を高め、メインテナンスの 和度を少なくすることができる。

ここで、上述した減圧装置では、液体トラップ 10で発生する水蒸気がプロセスチューブ1内に 逆流し、反応に阻害を与える危惧があるため、本 実施例では液体トラップ10の前段にコールドト ラップ11を設け、水蒸気を液化して液体トラップ10に戻すように構成している。

また、上記実施例のように、バキューム経路 7 をバイパスさせて液体トラップを行っている関山は、バキューム経路 7 途中に液体トラップ 1 0 を配置した場合には、真空引きの際の排気抵抗が大きくなってその効率が駆化するからであり、このようにバイパスさせることで副生成物のトラップと真空引き作用とを共に効率よく実施することができる。

次に、本乳叨の他の実施例として、縦型のシリ

模型炉の場合は基本的にはプロセスチューブ内をボートが接触して移動し、ウエハの装填、取り出しを行なう炉の内部、すなわちプロセスチューブの内部には無処理によって堆積物が付着しているのでボートがプロセスチューブに対して接触して移動すると堆積物に接触し、これが不純物として半導体ウエハに付着してしまうという問題がある。

縦型炉では、半導体ウエハ6を搭載するボート 35の搬入方向が自策方向と一致するので、ボート35とプロセスチューブ31とを非接触で搬入 出可能であるので、パーティクルの発生がなく半 導体ウエハ6の歩間まりを向上することができる。

また、特に半導体ウエハの反応炉ではクリーンルーム内の単位面積あたりのコストが高いので省スペース化の要請があるが、縦型炉とすれば縦方向にスペースを要するので設置面積は模型炉よりも大幅に橋小され、プロセスチューブ31の周囲の加熱手段33の構造上の径の制約もないので大口径化が可能となる。

コンエピタキシャル成長装改について第2例を3 明して説明する。

第2図では、プロセスチューブ31を垂直軸に 沿って立て、たとえばその上端にガス弾入口32 を形成し、下側に無排気繁34を配置し、縦型川 ボート35に半弾体ウエハ6を水平状態で配列支 持して、下側の熱排気第34図よりプロセスチュ ーブ31内に搬入出可能としている。

そして、上記無排気室34に接続されるパキューム経路7及び排気経路8等の構成は、上述した第1実施例と同様になっている。

ここで、このような報型のシリコンエピタキシャル成長装置でも、プロセスチューブ 1 内での反応による副生成物の生成は同様であるので、これを排気経路途中でトラップする必要があり、上記の構成により、第 1 実施例とまったく同様にして副生成物等のトラップが可能である。

そして、このように超型でシリコンエピタキシャル成長装置を構成した場合のメリットとしては、 下記に示す通りである。

さらに、模型炉は自動化、大口径化が困難であるばかりか、炉内対流によりウエハの上下で温度 売が生ずるため歩留まりが思く、外部 O 2 の をひまりが多いので不要な酸化膜が生じ、膜厚の制御 が困難である等の問題がある。これに対して 縦型炉に比べれば半導体ウエハ の全面に対する温度、ガスの 均一性が向上し、か からも歩留まりを向上することが可能となる。

以上、本発明の実施例について説明したが、本 発明は上記実施例に限定されるものではなく、本 発明の要旨の範囲内で稀々の変形実施が可能であ る。

たとえば、上述した各実施例は共にシリコンエ ピタキシャル成長装置について説明したが、反応 窓内で反応を実施し、かつ、副生成物を排気する 他の種々の反応装置に適用可能であることはいう までもない。また、上記実施例では減圧反応装置 としての例を示したが、これに限らず常圧、加圧 の反応装置にも同様に適用することができる。常

### 特別平1-218013(5)

圧の場合には、バキューム経路7を別間に必要としないので、バイパス構成は不要であり、しかもコールドトラップ11も不要であり、より簡易に 実施することができる。

[発明の効果]

1 0 ··· トラップ手段、 1 1 ··· コールドトラップ、 V 1 ~ V 4 ··· バルブ。

代理人 弁理士 非 上 一(他1名)

以上説明したように、本発明によれば反応室内で生成された制生成物を、排気経路途中でトラップすることができるので、制生成物の排出に起因する従来の腐蝕等の問題を解消することができ、排気経路及び排気駆動器の舞命を高めると兆に、そのメインテナンスの頻度を従来よりも大幅に低減することが可能となる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明の一束施例である模型のシリコンエピタキシャル成長装置を説明するための概略説明図、

第2図は、本発明の他の実施例である線型のシ リコンエピタキシャル成長装置を説明するための 類略説明図である。

1,31…アロセスチューブ、

5,35…ポート、

6…半導体ウエハ、

7…パキューム経路、

8…排気轻路、

#### 第 | 図

